

## BEST AVAILABLE COPY

001996-0034343

(18) 대한민국특허청(KR)

(12) 공개특허공보(A)

(15) Int. Cl.  
D06F 9/00(11) 공개번호 특 1996-0034343  
(16) 공개일자 1996.11.22(21) 출원번호 1995-0004725  
(22) 출원일자 1995.03.19(23) 출원인 가시오 기아스카 기브시끼기미사 가시오 가즈오  
일본국 도쿄도 신주쿠구 나시신주쿠 2초메 6번지고(24) 대응자 셰인 미도리  
일본국 도쿄도 신주쿠구 미도리가오카 4-10-11

(25) 대리인 주은진

2. 제1항

(54) 1000도자금 충당제 및 그것을 이용한 도전집금구조

본 발명은 전방향의 결연성을 충분히 확보하고 또, 서로 대립하는 결속부기관의 전기 저항률 낮기로 인수하는 미방도전성접촉제 및 그것을 이용한 도전집금구조를 제공하기 위한 것으로서 제1접촉단자에 설치된 제1접촉단자와 제2접촉단자로, 접촉판 및 제2접촉단자의 사이에는 미방도전성 접촉제가 설치되어 있다. 이 미방도전성 접촉제는 결연성 접촉제 등에 제1도전성입자와 제2도전성입자를 혼합하여 형성되어 있다. 여기에서 제1도전성입자는 표면에는 결연성피막이 피복되어 있고 또, 제2도전성입자의 표면에는 결연성피막은 피복되어 있지 않다.

제1 및 제2접촉단자에 의해 미방도전성 접촉제를 넣었을 때나 제1도전성입자를 피복하는 결연성피막에 의하여 제1 및 제2접촉단자에 부설되는 부분이 피복되어 제1도전성입자에 있어서 결연성접촉제의 미피복부에서 노출된 부분이 제1 및 제2접촉단자에 정착으로 접촉된다 동시에 제2도전성입자가 제1 및 제2의 접촉단자에 그들과 연하는 부분에서 전기적으로 접속된다.

제2도전성입자는 그 표면에 결연성피막이 피복되어 있으면서 미방도전성접촉제는 미방도전성으로는 결연성을 가짐과 동시에 제2도전성입자는 그 표면이 결연성피막으로 피복되어 있지 않으므로 제1 및 제2의 접촉단자 사이에는 원조한 전기적접속이 이루어진다.

3. 제2항

(발명의 명칭)

미방도전성 접착제 및 그것을 이용한 도전집금구조

본 것은 보통공개 경이므로 전문파행을 조특하지 않았음

(57) 출수국 일본

원인장 1

결연성접촉제(16)와 상기 결연성접촉제(16) 중에 출원되고, 표면에 결연성피막(14)이 설치된 제1도전성입자(15)와 상기 결연성접촉제(16) 중에 출원되고, 표면에 결연성피막(14)이 설치되어 있지 않은 제2도전성입자(15)로 구성되는 것을 특징으로 하는 미방도전성 접착제.

원인장 2

상기 항에 있어서 상기 제1도전성입자(15)의 개수는 상기 제2도전성입자(15)의 개수 미상인 것을 특징으로 하는 미방도전성 접착제.

원인장 3

상기 항에 있어서 상기 제1도전성입자(15) 및 상기 제2도전성입자(15)의 적어도 한쪽은 소자입자(17)의 표면을 도전성피막(18)으로 피복되어 되는 입자로 구성되는 것을 특징으로 하는 미방도전성 접착제.

원인장 4

제1접촉단자(11)와 상기 제1접촉단자(11)에 대향하여 배치된 제2접촉단자(2)와, 상기 제1 및 제2접촉단자(11, 2) 사이에 개재되고, 표면에 결연성피막(14)이 설치된 제1도전성입자(15)와, 상기 제1 및 제2접촉단자(11, 2) 사이에 개재되고, 표면에 결연성피막(14)이 설치되어 있지 않은 제2도전성입자(15)와 상기 제1 및 제2접촉단자(11, 2) 사이의 표면에 충전된 결연성접촉제(16)로 구성되고, 상기 제1도전성입자(15)에 설치된 상기 결연성피막(14)에 있어서 상기 제1 및 제2접촉단자(11, 2)에 단이는 부분이

파손되어 상기 제1도장성 입자(15)에 있어서 상기 펠트 스파크(4)의 미 파손부에서 노출된 부분이 상기 제1 및 제2접속단자(11, 12)에 전기적으로 접속되어 있을과 동시에 상기 제2도장성 입자(15a)가 상기 제1 및 제2접속단자(11, 12)에 그물고 멈하는 부분에 있어서 전기적으로 접속되어 있는 것을 특징으로 하는 도전 접속구조.

(※ 참고자료) 초초증원 내용에 의하여 공개하는 것임.

**BEST AVAILABLE COPY**